

---

# 南亞電路板股份有限公司 2019年前三季營運概況

2019年12月4日



## 免責聲明

---

歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前南亞電路板股份有限公司之財務狀況或營運結果。

本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與本會明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。

除主管機關要求公開之資訊外，本公司並無義務揭露或更新對未來產品方面之意見與看法。



# 議程

---

- 公司概況
- 財務狀況
- 產品未來發展方向
- 未來營運目標



# 公司概況

## 事業簡述

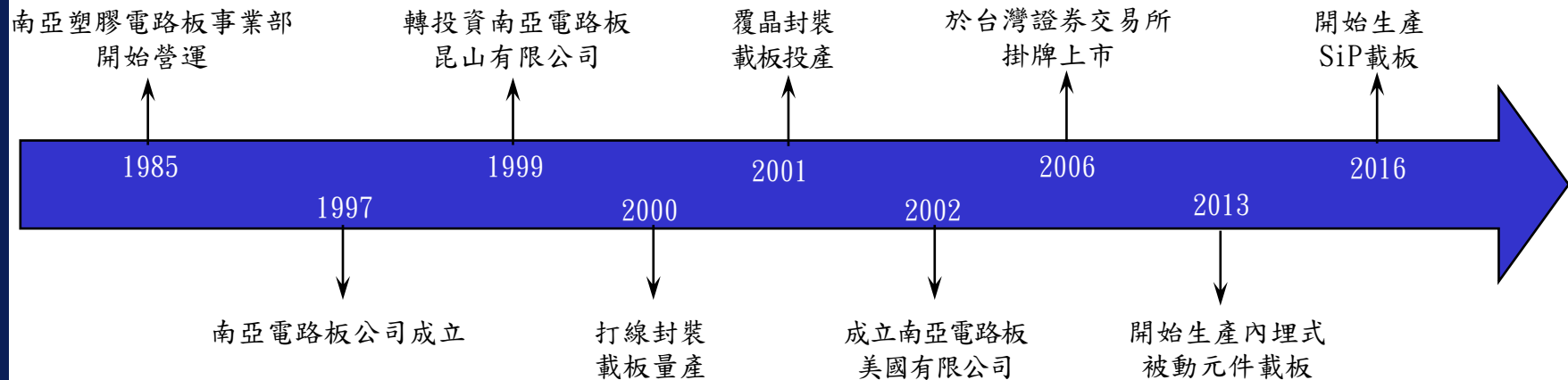
---

- 南亞塑膠工業股份有限公司之轉投資公司
- 生產與銷售一般電路板與IC載板
- 2019年前三季合併營業額為新台幣 223.2億元。
- 台股上市市值：新台幣327.0億元(2019年9月27日)
- 生產廠區：台灣、大陸



# 公司概況

## 歷史沿革



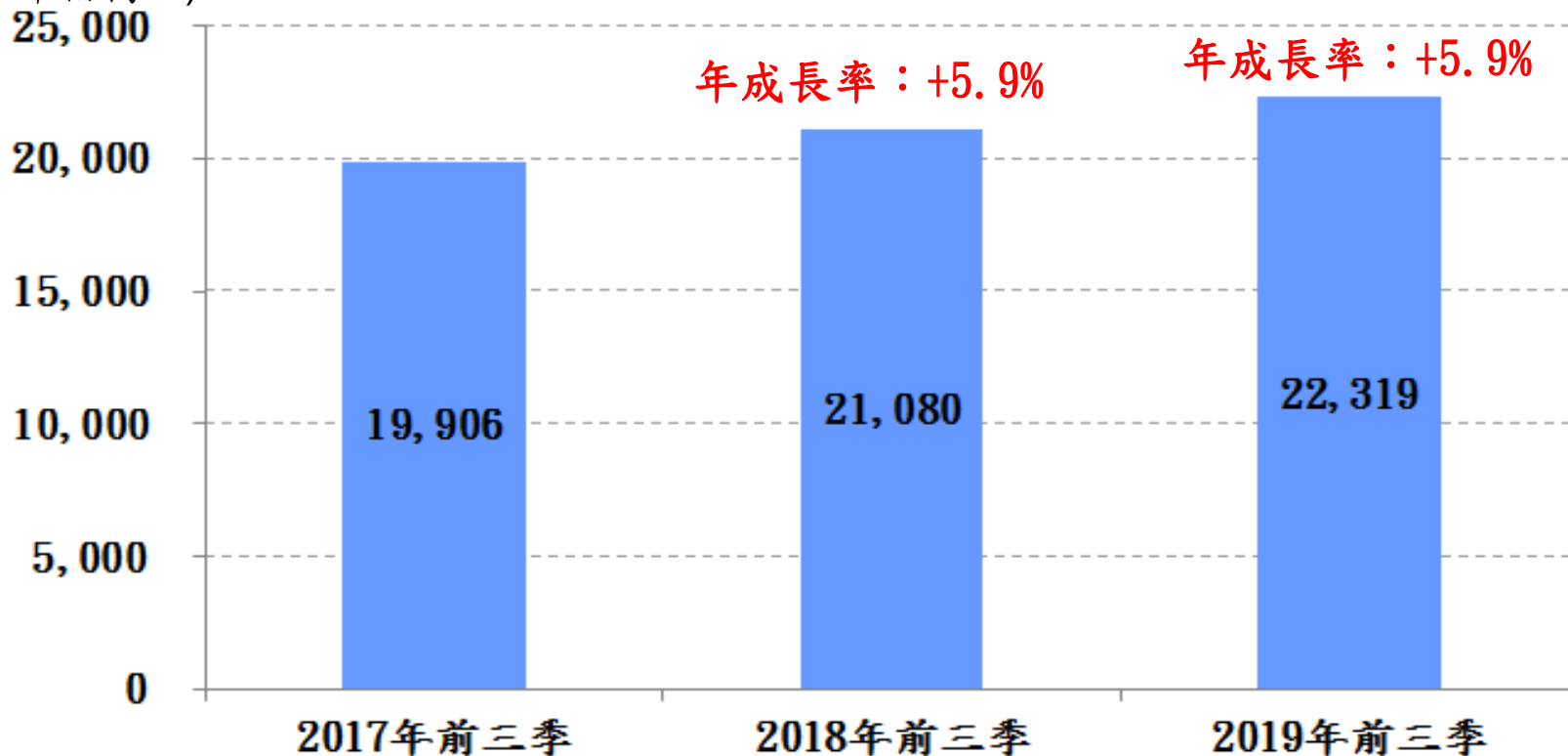
- 1985 : 南亞塑膠公司電路板事業部成立並開始生產一般電路板
- 1997 : 經南亞塑膠董事會通過，以轉投資方式成立南亞電路板公司
- 1999 : 轉投資南亞電路板(昆山)有限公司，註冊資本額2,980萬美元
- 2000 : 進入IC載板領域並量產打線封裝載板
- 2001 : 進行技術升級，開始投產覆晶封裝載板
- 2002 : 成立南亞電路板(美國)有限公司
- 2006 : 正式於台灣證券交易所掛牌上市，交易代號為8046
- 2013 : 產品技術升級，開始生產內埋式被動元件載板
- 2016 : 開始生產系統級封裝載板(System in Package, SiP)



# 財務狀況

## 近三年合併營業收入(IFRS)

(新台幣佰萬元)



- 2018年前三季營收較2017年同期成長5.9%:

本公司致力開發5G網通與穿戴式裝置等高值化產品，平均單價上升，故2018年前三季營收比2017年同期成長。

- 2019年前三季營收較2018年同期成長5.9%:

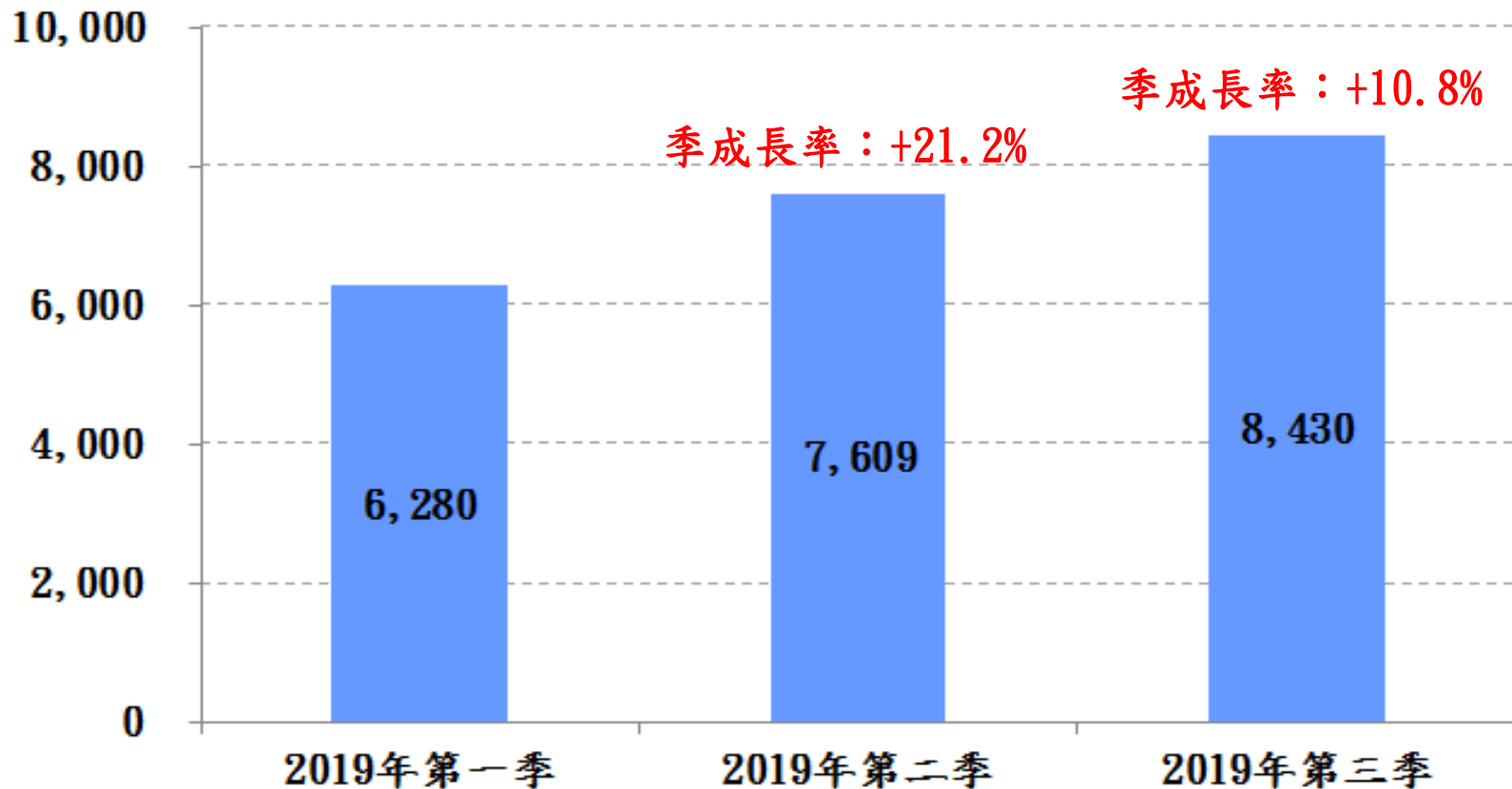
本公司持續配合5G網通客戶需求，高階IC載板訂單比重增加，故2019年前三季營收比2018年同期成長。



# 財務狀況

## 近三季合併營業收入(IFRS)

(新台幣佰萬元)



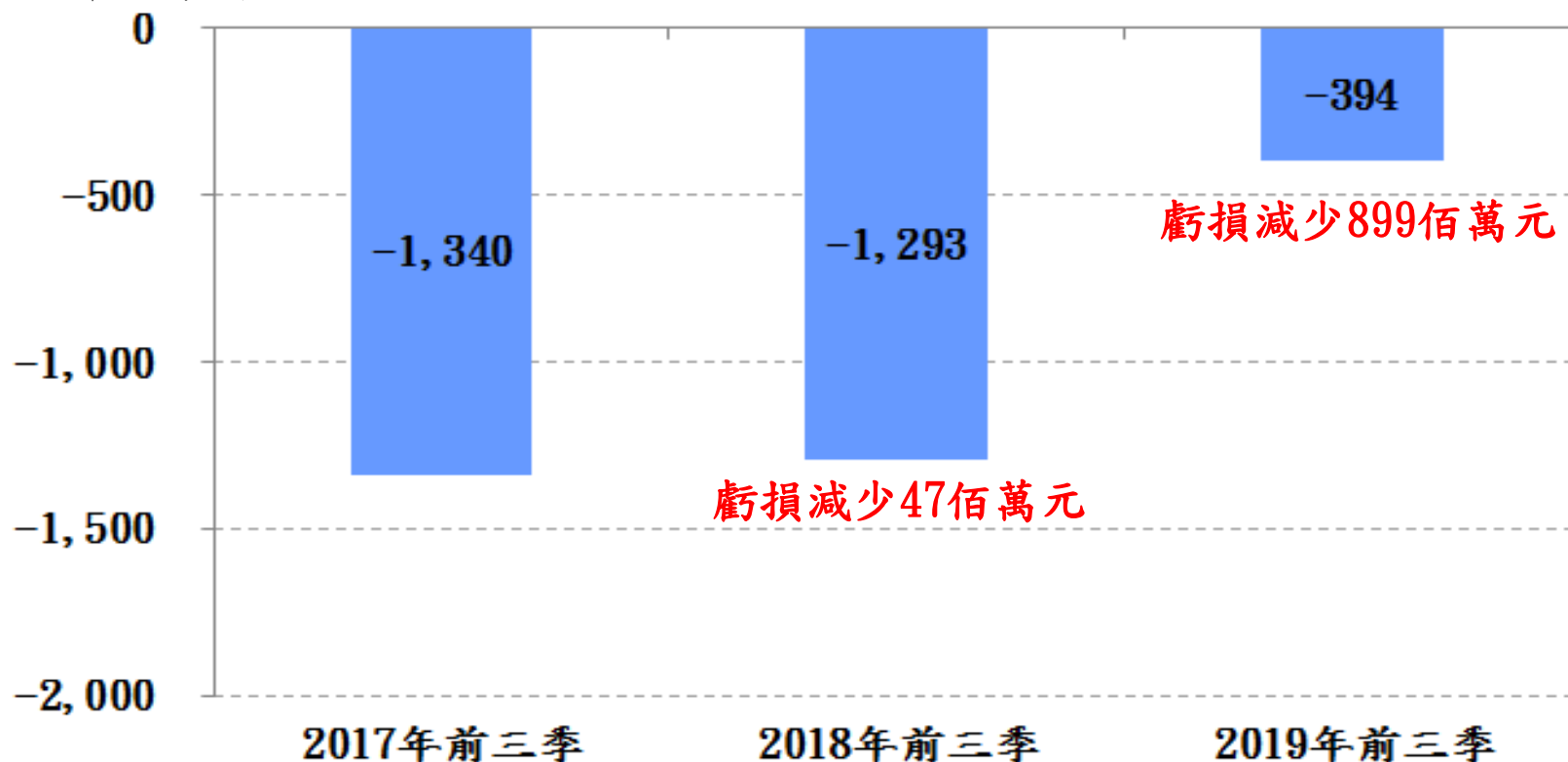
- 2019年第二季營收較第一季成長21.2%:  
2019年第二季5G網通產品銷售顯著增加，故第二季營收季成長21.2%。
- 2019年第三季營收較第二季成長10.8%:  
2019年第三季因系統級封裝(SiP)載板需求符合市場預期，且5G網通、人工智慧及高效運算產品銷售續旺，故第三季營收持續成長。



# 財務狀況

## 近三年營業利益(虧損)

(新台幣佰萬元)



### ■ 2018年前三季營業虧損較2017年同期減少47佰萬元:

本公司2018年致力於提升高值化產品銷售比重，改善產品組合，使2018年前三季營業虧損比2017年同期減少。

### ■ 2019年前三季營業虧損較2018年同期減少899佰萬元:

本公司2019年持續與網通客戶緊密合作，5G網通產品出貨量持續增加，故2019年前三季營業虧損比2018年同期大幅減少。



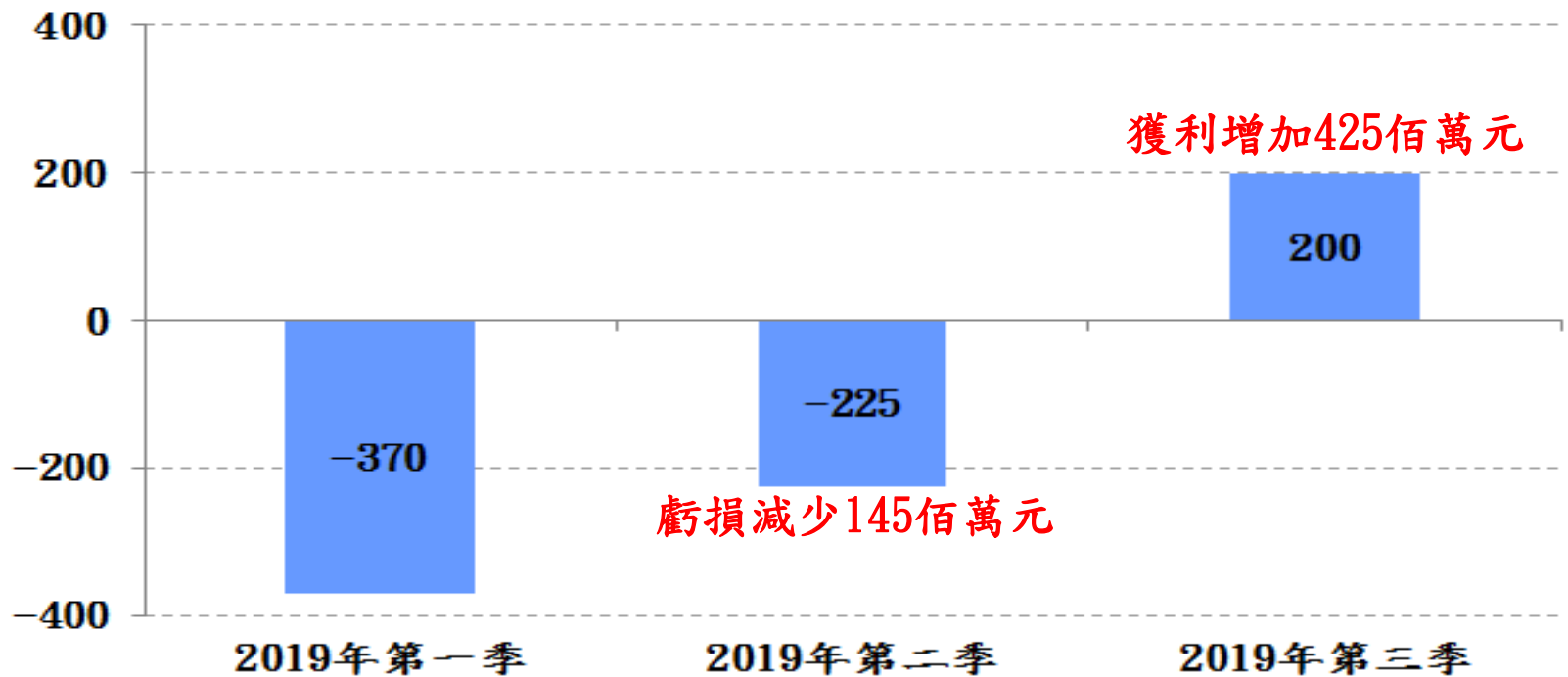


# 財務狀況

## 近三季營業利益(虧損)

(新台幣佰萬元)

營業利益

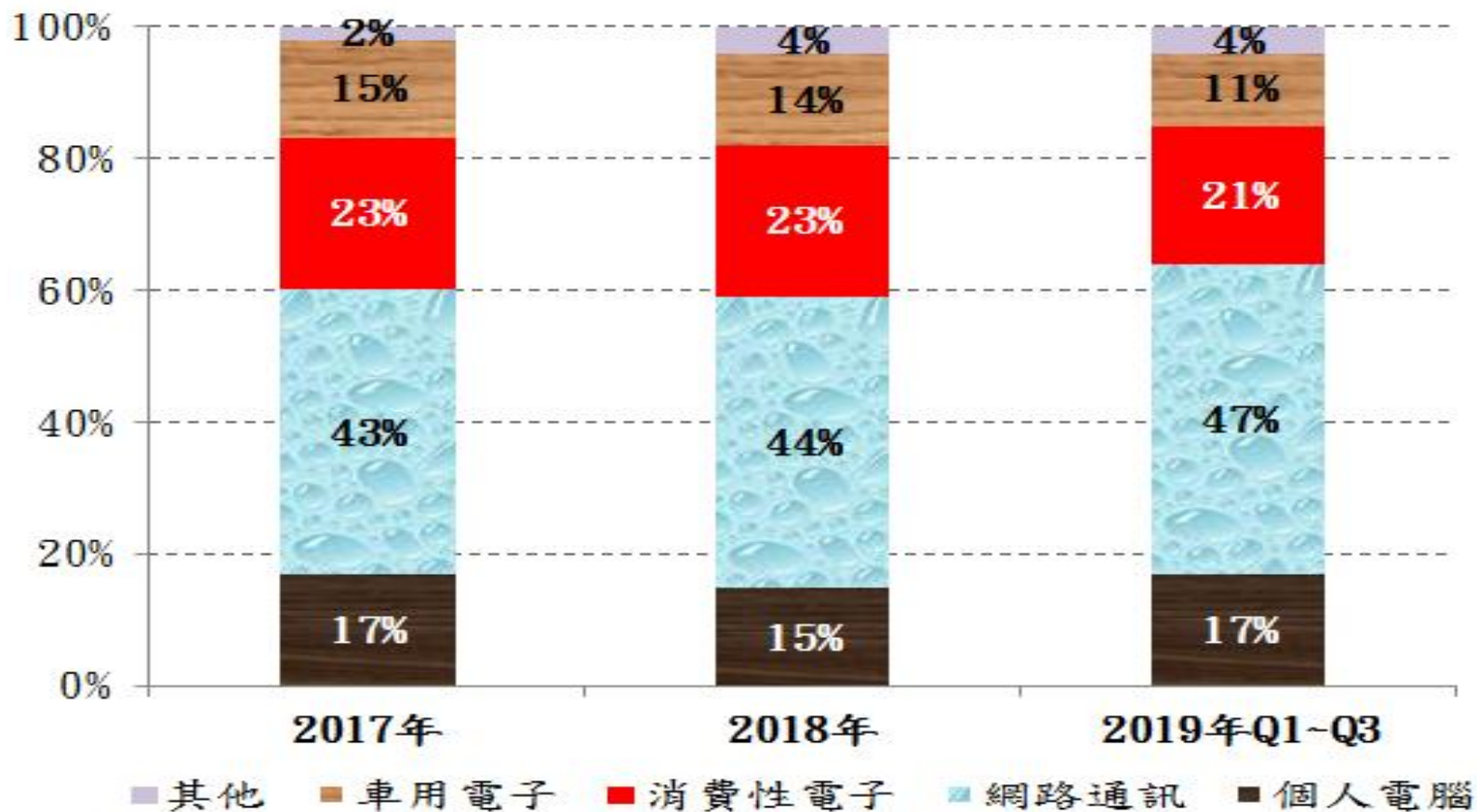


- 2019年第二季營業虧損較第一季減少145佰萬元：  
因5G網通客戶需求逐漸增加，第二季產能利用率提高，故第二季虧損比第一季減少。
- 2019年第三季營業利益較第二季增加425佰萬元：  
因網通與SiP載板等高值化產品出貨量增加，且不斷優化生產製程技術，提高生產良率，致2019年第三季本業轉虧為盈。



# 財務狀況

## 營業收入結構(應用別1/2)

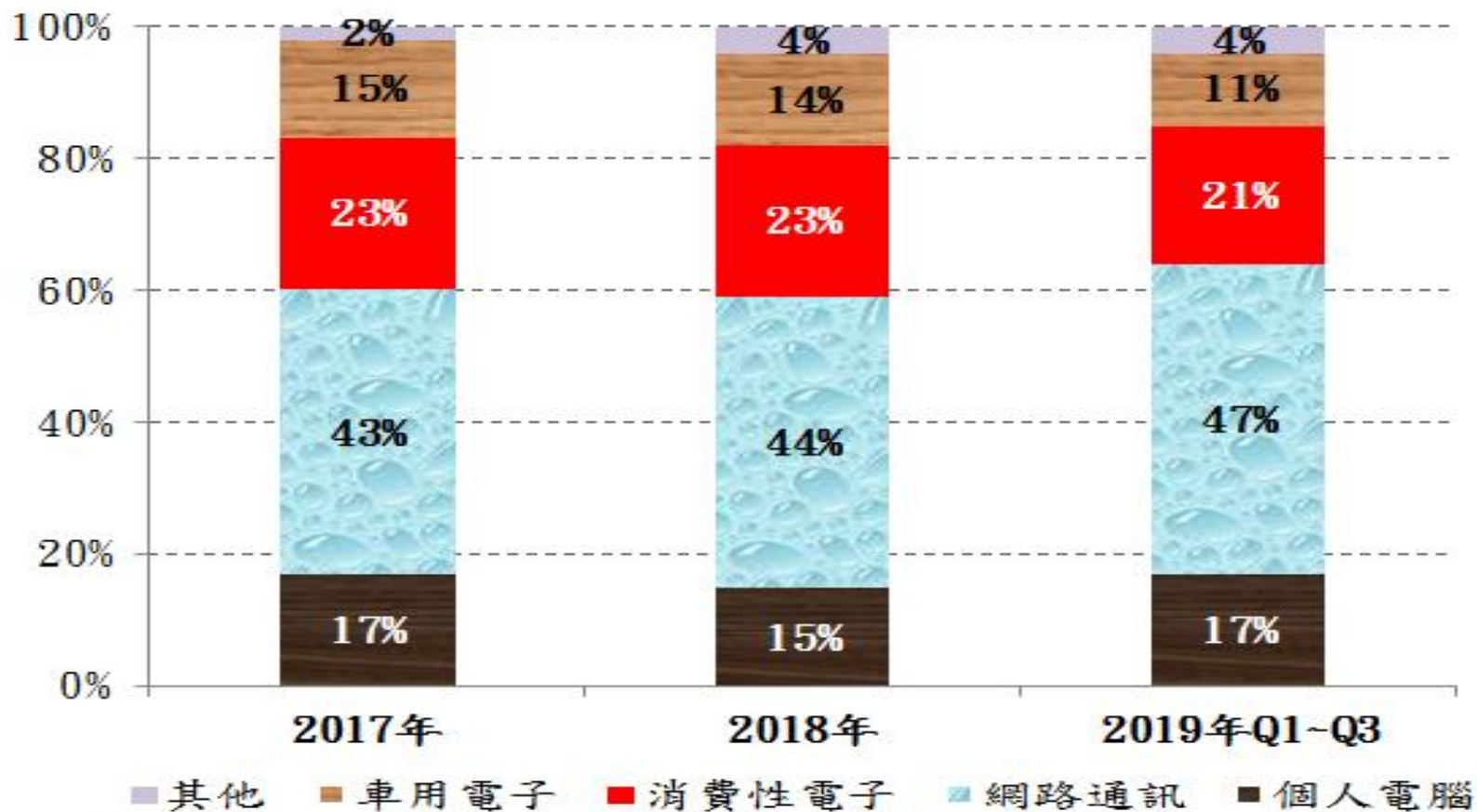


- 本公司與個人電腦及高階網路通訊客戶緊密配合，在客戶端市占率不斷提高的狀況下，2019年前三季個人電腦與網路通訊產品營收貢獻提高。
- 受到電視與遊戲機等產品銷售不佳影響，消費性電子產品佔營收比重略微降低。



# 財務狀況

## 營業收入結構(應用別2/2)



- 因中美貿易糾紛導致全球景氣低迷，終端汽車市場銷售疲弱，影響車用電子需求，故2019年前三季車用電路板營收占比下滑。
- 2018年上半年加密貨幣需求強勁，但自下半年起熱潮逐漸衰退；然而，由於本公司致力開發人工智慧與高效運算等產品，2019年前三季其他類營收比重維持不變。



# 產品未來發展方向

## 持續拓展高值化產品

### ■ 5G網通設備

2020年將持續與客戶合作，量產高層數大尺寸網通應用產品，以提高平均單價與獲利。

### ■ SiP載板

伴隨高階封裝技術持續演進，除了高階行動裝置與穿戴式裝置等產品外，相機模組也將採用更多SiP載板，以符合電子產品輕、薄、短、小之發展趨勢，本公司SiP載板產品出貨量可望持續增加。

### ■ HDI(高密度連接板)產品

未來在汽車、真無線藍芽耳機、筆電及高階記憶體等電子產品都將因產品設計的複雜度提高，而採用更多高密度連接板，因此本公司亦將逐步提高HDI產品比重與產能，以因應未來市場的需求。

### ■ 人工智慧/高效運算

人工智慧與高效運算晶片因產品設計複雜，故須配合高層數與散熱佳之高階IC載板，在人工智慧與高效運算持續發展下，將帶動IC載板的需求量與價穩定增加。



# 未來營運目標

## 公司追求營業利益轉虧為盈

### ■ 2019年第三季本業轉虧為盈

本公司高層數大尺寸IC載板等High Value產品出貨量穩健成長，且持續優化生產製程技術，產品良率逐漸提升，故2019年第三季本業轉虧為盈，2019年前三季稅前淨利亦轉為獲利。

### ■ 2019年第四季產品組合與生產良率持續改善

因5G網路基礎設備建置的需求擴大，本公司高層數大尺寸IC載板等High Value產品訂單續旺，產品組合持續改善；此外，生產良率亦有穩定提升。

### ■ 2020年追求獲利持續成長

**開源：**5G網通基礎建設與人工智慧/高效運算等需求可望帶動大尺寸高層數IC載板產品需求持續成長；此外，半導體異質整合封裝技術發展趨勢不變，將帶動SiP載板產品需求穩定提升。

**節流：**本公司未來將持續進行製程優化，導入人工智慧與先進生產技術，提升良率，並持續推動各項用人、用料改善專案，以降低生產成本。



感謝您的聆聽

